

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-292625
(43)Date of publication of application : 21.10.2004

(51)Int.Cl.

C08J 5/00
C08K 5/20
C08L 67/04
// (C08L 67/04
C08L 59:00)

(21)Application number : 2003-086556
(22)Date of filing : 26.03.2003

(71)Applicant : TORAY IND INC
(72)Inventor : KUMAZAWA SADANORI
OOME HIROKAZU
KUMAKI JIRO

(54) MOLDING AND ITS MANUFACTURING PROCESS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transparent and crystallized molding excellent in transparency and heat resistance and its manufacturing process.

SOLUTION: The crystallized molding is composed of a compound of a polylactic acid resin and a polyacetal resin, and transparent. The crystallization rate of the molding as expressed by formula (1) is $\geq 60\%$. Formula (1): $[(\Delta H_m - \Delta H_c) / \Delta H_m] \times 100$, wherein, ΔH_m represents enthalpy of melting of the crystal of the molding; ΔH_c represents enthalpy of crystallization in rising temperature. Preferably, an amide compound is compounded.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-292625

(P2004-292625A)

(43) 公開日 平成16年10月21日 (2004.10.21)

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
C O 8 J 5/00	C O 8 J 5/00	4 F O 7 1
C O 8 K 5/20	C O 8 K 5/20	4 J O O 2
C O 8 L 67/04	C O 8 L 67/04	
//(C O 8 L 67/04	C O 8 L 67/04	
C O 8 L 59:00)	C O 8 L 59:00	
審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 21 頁)		
(21) 出願番号	特願2003-86556 (P2003-86556)	
(22) 出願日	平成15年3月26日 (2003. 3. 26)	
(71) 出願人	000003159 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号	
(72) 発明者	熊澤 貞紀 愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東 レ株式会社名古屋事業場内	
(72) 発明者	大目 裕千 愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東 レ株式会社名古屋事業場内	
(72) 発明者	熊木 治郎 愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東 レ株式会社名古屋事業場内	
最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 成形体およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 透明性と耐熱性に優れた透明かつ結晶化した成形体およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物からなる、透明かつ下記式 (1) で表される成形体の結晶化の割合が60%以上である結晶化した成形体。

$$[(\Delta H_m - \Delta H_c) / \Delta H_m] \times 100 \quad (1)$$

〔式中、 ΔH_m は成形体の結晶融解エンタルピーを表し、 ΔH_c は成形体の昇温時結晶化エンタルピーを表す。〕さらにアミド化合物を配合することが好ましい。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物からなる、透明かつ下記式(1)で表される成形体の結晶化の割合が60%以上である成形体。

$$[(\Delta H_m - \Delta H_c) / \Delta H_m] \times 100 \quad (1)$$

〔式中、 ΔH_m は成形体の結晶融解エンタルピーを表し、 ΔH_c は成形体の昇温時結晶化エンタルピーを表す。〕

【請求項 2】

前記ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂の合計を100重量部としたときに、ポリ乳酸樹脂99～50重量部である請求項1に記載の成形体。

10

【請求項 3】

前記樹脂組成物がさらにアミド化合物を配合してなるものである請求項1または2に記載の成形体。

【請求項 4】

前記ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂の合計を100重量部としたときに、前記アミド化合物の配合量が0.1～10重量部である請求項1～3のいずれかに記載の成形体。

【請求項 5】

前記アミド化合物が、脂環族アミドおよび芳香族アミドから選択される少なくとも1種である請求項1～4のいずれかに記載の成形体。

20

【請求項 6】

前記アミド化合物が、N, N'-ジシクロヘキサンカルボニル-1, 4-ジアミノシクロヘキサン、トリメシン酸トリス(t-ブチルアミド)、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸ジアニリド、テレフタル酸ジアニリドから選択される少なくとも1種である請求項1～5のいずれかに記載の成形体。

【請求項 7】

厚みが20 μ m以上で、ヘイズ値が30%以下である部分を有する請求項1～6のいずれかに記載の成形体。

【請求項 8】

請求項1～7のいずれかに記載の成形体を製造する方法であって、ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物を成形し、その後にポリ乳酸樹脂のガラス転移温度以上ポリ乳酸樹脂の融点以下の温度範囲で熱処理することを特徴とする成形体の製造方法。

30

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂を配合してなり、透明性と耐熱性に優れ、かつ十分に結晶化した成形体およびその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

ポリ乳酸樹脂は、生分解性を有し、かつ高い融点を持ち、また溶融成形可能であり、成形直後は透明な非晶性成形体として得られるため、実用上優れた生分解性ポリマーとして期待されている。しかし、透明な成形体の状態では、非晶性であるために、耐熱性に劣るという実用上の大きな問題があった。

40

【0003】

この耐熱性を向上させるために、成形時に金型温度を結晶化温度付近に保持したり、成形後に得た透明な成形体を熱処理するなどして結晶化度を上げると球晶サイズが可視光の波長よりも大きくなり不透明となるので、透明性と耐熱性を両立させるのは大変難しい問題であった。

【0004】

50

この問題に対して、特許文献1や特許文献2では、特定の温度範囲に融点を有する化合物を脂肪族ポリエステル、特にポリ乳酸樹脂に配合して、成形時もしくは成形直後に結晶化させる方法が開示されている。しかし、この方法においては、透明性は向上するものの、耐熱性はまだ十分に満足するまでには至っていない。

【0005】

一方、2種またはそれ以上のポリマーを配合して用いる技術は、ポリマーアロイとして広く知られており、このポリマーアロイは個々のポリマーの欠点を改良する目的で広く利用されている。しかしながら、2種以上のポリマーを混合した場合、多くはポリマー同士の分散性が悪く、ペレットや成形品の形状に加工できなかつたり、劣った特性を示す傾向となる。

【0006】

しかし、まれに2種のポリマーが均一な非晶相を形成する場合があります、この種のものは一般に相溶性または混和性のポリマーアロイとして、透明性など優れた特性を示すことが期待されているが、その例は少ない。

【0007】

ポリ乳酸樹脂と相溶性のあるポリマーとしては、ポリエチレングリコール（例えば、非特許文献1）や、ポリメチルメタクリレート（例えば、非特許文献2）が知られているが、これらのポリマーを混合した場合には、ポリ乳酸樹脂の耐熱性が大きく低下してしまうという問題があった。

【0008】

また、ポリアセタール樹脂と相溶性のあるポリマーとしては、ポリビニルフェノール（例えば、非特許文献3）が知られているが、ポリビニルフェノールは分子量が一般に低いことから、この場合には混合後の樹脂物性が低下するという問題があった。

【0009】

一方、特許文献3には、ポリ乳酸樹脂とポリアセタール樹脂が相溶することが開示されている。しかしながら、同文献記載の方法を用いても透明かつ結晶化した成形体を得るまでには至っていない。

【0010】

【特許文献1】

特開平9-278991号公報（[0018] - [0045] 段落）

【特許文献2】

特開平11-5849号公報（[0013] - [0023] 段落）

【特許文献3】

国際公開第03/014224号パンフレット

【非特許文献1】

Polymer 37 (26), 5849-5857頁 (1996)

【非特許文献2】

Polymer 39 (26), 6891-6897頁 (1998)

【非特許文献3】

Polymer 33 (4), 760-766頁 (1992)

【0011】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果達成されたものであり、その目的とするところは、透明性と耐熱性に優れ、かつ十分に結晶化した成形体およびその製造方法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、ポリ乳酸樹脂、ポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物が、上記の目的に合致した優れた特性を発揮することを見出し、本発明に到達した。

10

20

30

40

50

【0013】

すなわち、本発明は、

(1) ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物からなる、透明かつ下記式(1)で表される成形体の結晶化の割合が60%以上である成形体、

$$[(\Delta H_m - \Delta H_c) / \Delta H_m] \times 100 \quad (1)$$

[式中、 ΔH_m は成形体の結晶融解エンタルピーを表し、 ΔH_c は成形体の昇温時結晶化エンタルピーを表す。]

(2) 前記ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂の合計を100重量部としたときに、ポリ乳酸樹脂99～50重量部である上記(1)に記載の成形体、

(3) 前記樹脂組成物がさらにアミド化合物を配合してなるものである上記(1)または(2)に記載の成形体、

(4) 前記ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂の合計を100重量部としたときに、前記アミド化合物の配合量が0.1～10重量部である上記(1)～(3)のいずれかに記載の成形体、

(5) 前記アミド化合物が、脂環族アミドおよび芳香族アミドであるから選択される少なくとも1種上記(1)～(4)のいずれかに記載の成形体、

(6) 前記アミド化合物が、N, N'-ジシクロヘキサンカルボニル-1, 4-ジアミノシクロヘキサン、トリメシン酸トリス(t-ブチルアミド)、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸ジアニリド、テレフタル酸ジアニリドから選択される少なくとも1種である上記(1)～(5)のいずれかに記載の成形体、

(7) 厚みが20 μ m以上でヘイズ値が30%以下である部分を有する上記(1)～(6)のいずれかに記載の成形体、および

(8) 上記(1)～(7)のいずれかに記載の成形体を製造する方法であって、ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物を成形し、その後、ポリ乳酸樹脂のガラス転移温度以上ポリ乳酸樹脂の融点以下の温度範囲で熱処理することを特徴とする成形体の製造方法である。

【0014】

【発明の実施の形態】

以下、本発明について詳細に説明する。

【0015】

本発明に用いられるポリ乳酸樹脂とは、L-乳酸および/またはD-乳酸を主たる構成成分とするポリマーであるが、本発明の目的を損なわない範囲で、乳酸以外の他の共重合成分を他のモノマー単位として含んでいてもよい。ここでいう他のモノマー単位の具体例としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ヘプタンジオール、ヘキサンジオール、オクタンジオール、ノナンジオール、デカンジオール、1, 4-シクロヘキサンジメタノール、ネオペンチルグリコール、グリセリン、ペンタエリスリトール、ビスフェノールA、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールおよびポリテトラメチレングリコールなどのグリコール化合物、シュウ酸、アジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸、ドデカンジオン酸、マロン酸、グルタル酸、シクロヘキサンジカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、ナフタレンジカルボン酸、ビス(p-カルボキシフェニル)メタン、アントラセンジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルエーテルジカルボン酸、5-ナトリウムスルホイソフタル酸および5-テトラブチルホスホニウムイソフタル酸などのジカルボン酸、グリコール酸、ヒドロキシプロピオン酸、ヒドロキシ酪酸、ヒドロキシ吉草酸、ヒドロキシカプロン酸およびヒドロキシ安息香酸などのヒドロキシカルボン酸、カプロラクトン、バレロラクトン、プロピオラクトン、ウンデカラクトンおよび1, 5-オキセパン-2-オンなどのラクトン類などを挙げることができる。これらの共重合成分は、単独ないし2種以上用いることができる。また、これらの共重合成分の含有量としては、全単量体成分中、通常30モル%以下の含有量とするのが好ましく、10モル%以下であることがより好ましい。

【0016】

本発明においては、相溶性の観点から、乳酸成分の光学純度が高いポリ乳酸樹脂を用いることが好ましい。すなわち、ポリ乳酸樹脂の総乳酸成分の内、L体が80%以上含まれるかあるいはD体が80%以上含まれることが好ましく、L体が90%以上含まれるかあるいはD体が90%以上含まれることがより好ましく、L体が95%以上含まれるかあるいはD体が95%以上含まれることがさらに好ましく、L体が98%以上含まれるかあるいはD体が98%以上含まれることが特に好ましい。また、L体またはD体の含有量の上限は通常100%以下である。

【0017】

ポリ乳酸樹脂の融点は、特に制限されるものではないが、120℃以上であることが好ましく、さらに150℃以上であることが好ましく、特に160℃以上であることが好ましい。ポリ乳酸樹脂の融点は、通常乳酸成分の光学純度を高くすることにより高くなり、融点が120℃以上のポリ乳酸樹脂は、L体が90%以上含まれるかあるいはD体が90%以上含まれることにより、また融点が150℃以上のポリ乳酸樹脂は、L体が95%以上含まれるかあるいはD体が95%以上含まれることにより、得ることができる。

10

【0018】

ポリ乳酸樹脂の分子量や分子量分布については、実質的に成形加工が可能であれば、特に制限されるものではないが、機械的特性に優れる成形体得られるという観点から、重量平均分子量としては、通常1万以上、好ましくは4万以上、さらに8万以上であることが好ましい。ここでいう重量平均分子量とは、溶媒としてヘキサフルオロイソプロパノールを用いたゲルパーミテーションクロマトグラフィー（GPC）で測定したポリメチルメタクリレート（PMA）換算の重量平均分子量である。

20

【0019】

ポリ乳酸樹脂の製造方法としては、公知の重合方法を用いることができ、乳酸からの直接重合法およびラクチドを介する開環重合法などを挙げることができる。

【0020】

本発明に用いられるポリアセタール樹脂は、オキシメチレン単位を主たる繰返し単位とするポリマーであり、ホルムアルデヒドもしくはトリオキサンを主原料として、重合反応によって得られる、いわゆるポリアセタールホモポリマー、あるいは主としてオキシメチレン単位からなり、主鎖中に2～8個の隣接する炭素原子を有するオキシアルキレン単位を15重量%以下含有するいわゆるポリアセタールコポリマーのいずれであってもよく、また他の構成単位を含有するコポリマー、すなわち、ブロックコポリマー、ターポリマー、架橋ポリマーのいずれであってもよく、これらは1種または2種以上で用いることができるが、熱安定性の観点からはポリアセタールコポリマーであることが好ましい。

30

【0021】

本発明におけるポリアセタール樹脂の製造方法については特に制限はなく、公知の方法により製造することができる。ポリアセタールホモポリマーの代表的な製造方法の例としては、高純度のホルムアルデヒドを有機アミン、有機あるいは無機の錫化合物、金属水酸化物のような塩基性重合触媒を含有する有機溶媒中に導入して重合し、重合体を濾別した後、無水酢酸中、酢酸ナトリウムの存在下で加熱してポリマー末端をアセチル化して製造する方法などが挙げられる。

40

【0022】

また、代表的なポリアセタールコポリマーの製造方法としては、高純度のトリオキサンおよびエチレンオキシドや1,3-ジオキソランなどの共重合成分を、シクロヘキサンのような有機溶媒中に導入し、三弗化ホウ素ジエチルエーテル錯体のようなルイス酸触媒を用いてカチオン重合した後、触媒の失活と末端基の安定化を行うことによる製造法、あるいは溶媒を全く使用せずに、セルフクリーニング型攪拌機の中へ、トリオキサン、共重合成分および触媒を導入して塊状重合した後、さらに不安定末端を分解除去することにより製造する方法などが挙げられる。

【0023】

これらポリアセタール樹脂の粘度については、成形材料として使用できる程度のものであ

50

れば特に制限はないが、ASTMD1238法によるメルトインデックス(MI)が測定可能であり、MIが1.0~50g/10分の範囲のものであることが好ましく、1.5~35g/10分のものであることが特に好ましい。

【0024】

また、ポリアセタール樹脂としては、あらかじめ熱安定剤や発生ガス捕捉剤を含有しているものを用いることが好ましく、2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-tert-ブチルフェノール)、カルシウムリシノレート、シアノグアナジン、ヘキサメチレンビス(3,5-tert-ブチル-4-ヒドロキシハイドロシアナメート)、メラミン-ホルムアルデヒド樹脂、ナイロン6/66、ナイロン66/610/6、ナイロン612/6、テトラキス[メチレン(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシヒドロシアナメート)]メタン、1,6-ヘキサンジオールビス[3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、トリエチレングリコール[3-(3,5-ジ-tert-ブチル-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]の少なくとも1種が含有されていることが好ましい(“/”は共重合を示す)。

10

【0025】

本発明において、ポリ乳酸樹脂とポリアセタール樹脂との配合組成は、透明性を有し、かつ結晶化の割合が本発明範囲内にある成形体の製造を容易にし、さらに優れた耐熱性を付与するために、ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂の合計100重量部に対し、ポリ乳酸樹脂99~50重量部とすることが好ましく、99~60重量部とすることがより好ましく、99~70重量部とすることがさらに好ましく、99~80重量部であることが最も好ましい。ポリ乳酸樹脂が99重量部を越えると耐熱性が不十分であり、50重量部未満であると透明性が損なわれる場合がある。また、この配合組成においては、ポリ乳酸樹脂が有する特性を活かして生分解性を伴ってもかまわない。

20

【0026】

本発明においては、成形品中でポリ乳酸樹脂とポリアセタール樹脂とは通常相溶化している。そのため、高結晶性のポリアセタール樹脂を使用しているにもかかわらず、透明性が達成できる。ここでいう「相溶化」とは、分子レベルで非晶相内に均一相を形成する重合体の混合物を形成することを説明するために用いられる。つまり、配合物の一方または両方が結晶相および非晶相の両方を形成する場合、相溶性とは、非晶相が分子レベルで混合していることを意味する。

30

【0027】

配合物中の相溶性の判断は、いくつかの方法で行うことができる。相溶性について判断する最も一般的な方法は、ガラス転移温度で判断する方法である。相溶性配合物中では、ガラス転移温度が各々単独のものより変化し、多くの場合、単一のガラス転移温度を示す。ガラス転移温度の測定方法としては、示差走査熱量計(DSC)で測定する方法、および動的粘弾性試験により測定する方法のいずれをも用いることができる。

【0028】

しかしながら、ポリアセタール樹脂は高結晶性であるために、ポリアセタール樹脂の含有量が多い場合には、ガラス転移温度が不明確になるという問題がある。この場合、相溶性の判断としては、ポリアセタール樹脂の結晶化温度を用いることができる。すなわち、ポリアセタール樹脂がそれ自体よりも結晶化速度の遅い樹脂と相溶性配合物を形成した場合には、ポリアセタール樹脂の結晶化速度が単体の場合よりも低下するからである。したがって、この結晶化速度の低下を、DSCで測定した降温時の結晶化温度で判断することができる。

40

【0029】

本発明においては、透明性と耐熱性がさらに向上するという観点から、アミド化合物を配合することが好ましい。

【0030】

本発明で用いるアミド化合物としては、通常アミド結合と呼ばれる結合を有する化合物であれば、特に限定されるものではなく、脂肪族アミド、脂環族アミド、芳香族アミドなど

50

いずれをも用いることができるが、特に透明性と耐熱性が向上するという観点から、脂環族アミド、芳香族アミドがより好ましい。

【0031】

脂肪族アミドとは、分子内に脂環もしくは芳香環などの環構造を一切含有しない鎖状分子で構成されるアミド化合物であれば、特に限定されるものではない。

【0032】

その具体例としては、酢酸アミド、プロピオン酸アミド、ラウリン酸アミド、パルチミン酸アミド、オレイン酸アミド、ステアリン酸アミド、エルカ酸アミド、ベヘニン酸アミド、リシノール酸アミド、ヒドロキシステアリン酸アミド、N-オレイルパルミチン酸アミド、N-オレイルオレイン酸アミド、N-ステアリルステアリン酸アミド、N-ステアリルエルカ酸アミド、メチロールステアリン酸アミド、メチロールベヘニン酸アミド、メチレンビスステアリン酸アミド、エチレンビスラウリン酸アミド、エチレンビスカプリン酸アミド、エチレンビスオレイン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミド、エチレンビスエルカ酸アミド、エチレンビスベヘニン酸アミド、エチレンビスイソステアリン酸アミド、エチレンビスヒドロキシステアリン酸アミド、ブチレンビスステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビスオレイン酸アミド、ヘキサメチレンビスステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビスベヘニン酸アミド、ヘキサメチレンビスステアリン酸アミド、シュウ酸アミド、マロン酸アミド、コハク酸アミド、グルタル酸アミド、アジピン酸アミド、ピメリン酸アミド、スベリン酸アミド、アゼライン酸アミド、セバシン酸アミド、1, 12-ドデカン二酸アミド、1, 14-テトラデカン二酸アミド、1, 18-オクタデカン二酸アミド、クエルボン酸アミド、メタントリカルボン酸アミド、トリカルボン酸アミド、プロパンボン酸アミド、ペンタントリカルボン酸アミド、エタントラカルボン酸アミド、プロパンボン酸アミド、ペンタントラカルボン酸アミド、1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン酸アミド、ドデカンテトラカルボン酸アミド、ペンタンペンタカルボン酸アミド、テトラデカヘキサカルボン酸アミド、エチレンジアミン四酢酸アミド、トリロ三酢酸アミド、エチレングリコールビス(β-アミノエチルエーテル)N, N, N', N'-四酢酸アミド、ジエチレントリアミン五酢酸アミド、N-ヒドロキシエチルエチレンジアミン-N, N', N'-三酢酸アミド、1, 3-ジアミノプロパン-2-オール-N, N', N'-四酢酸アミド、1, 2-ジアミノプロパン-N, N, N', N'-四酢酸アミド、トリエチレントトラミン六酢酸アミド、ニトリロ三プロピオン酸アミド、1, 6-ヘキサレンジアミン四酢酸アミド、N-(2-カルボキシエチル)イミノ二酢酸アミド、N, N'-ジオレイルセバシン酸アミド、N, N'-ジオレイルアジピン酸アミド、N, N'-ジステアリルアジピン酸アミド、N, N'-ジステアリルセバシン酸アミド、N, N'-ジアセチルエチレンジアミン、N, N'-ジエチルエチレンジアミン、N, N'-ジブチルエチレンジアミン、N, N'-ジアセチル-1, 6-ヘキサレンジアミン、N, N'-ジエチルカルボニル-1, 6-ヘキサレンジアミン、N, N'-ジブチルカルボニル-1, 6-ヘキサレンジアミン、N, N'-ジブチルカルボニル-1, 6-ヘキサレンジアミン、N-ブチル尿素、N-ステアリル尿素、N-プロピル-N'-ステアリル尿素、N, N'-ビスステアリル尿素、ヘキサメチレンビスステアリル尿素などが挙げられ、透明性と耐熱性が向上するという観点から、パルミチン酸アミド、ステアリン酸アミド、エルカ酸アミド、ベヘニン酸アミド、リシノール酸アミド、ヒドロキシステアリン酸アミド、N-オレイルパルミチン酸アミド、N-ステアリルエルカ酸アミド、エチレンビスカプリン酸アミド、エチレンビスオレイン酸アミド、エチレンビスラウリン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミド、N, N'-ジアセチルエチレンジアミン、N, N'-ジアセチル-1, 6-ヘキサレンジアミンが好ましく、さらにエチレンビスラウリン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミドがより好ましい。

【0033】

脂環族アミドとは、分子内に脂環構造を含有し、芳香環を含有しないアミド化合物であれば、特に限定されるものではない。

10

20

30

40

50

50

30

50

酸アミド、m-キシリレンジ安息香酸アミド、p-フ
エニレン酢酸アミド、イソフタル酸アミド、4-
タル酸アミド、1,8-ナフタル酸アミド、1,4-
、6-ナフタル酸アミド、3,4'-ビフェニルジカルボン酸アミド、ジ
ン酸アミド、4,3'-トリメリト酸アミド、ベンゾフェノンテトラ
ゼンテトラカルボンド酸アミド、ニルエテラカルボン酸アミド、
ラカルボン酸アミド、オントラカルボン酸アミド、ナフタレン
ミド、ペリレンテトラカルボン酸アミド、3,3'-ジカルボキシル
ード、ジフタル酸アミド、ベンゾカルボン酸アミド、ゼンヘ
、フタル酸アミド、ニルエテラカルボン酸アミド、ベンゾ
ル酸ジオレイルアミド、テラリルアミド、レフタル酸ジ
ナ、テレフタル酸ジス、テラリルアミド、レフタル酸
ナ、フタル酸ジカル、2,6-ナフタレンジカルボン酸
ヘキシルアミド、2,6-トリス(t-ブチルアミド)、トリ
ド)、キシルアミド、トリメリト酸トリス(t-ブチルアミド)、
ロヘキシルアニリド、酢酸アミド、酢酸アニリド、酢酸
2-メチルアニリド)、キシルアニリド、酢酸アミド、酢酸
クロヘキシルアニリド、酢酸アミド、酢酸アニリド、酢酸
酸アニリド、ラウリン酸ベンジルアミド、ラウリン酸
ウリン酸-p-トリステアリン酸ベンジルアミド、パルチ
リリド、ステアリン酸-p-トリステアリン酸ベンジルアミド、
リシノール酸アニリド、ヒドロキステアリン酸アニリド、
酸ジベンジルアミド、シュウ酸ビス(4-シクロヘキサ
ートルイジンアミド)、マロ酸ジベンジルアミド、コハ
ード、アジピン酸アニリド、アジピン酸ビス(p-トル
ヘキシルアニリド)、アジピン酸ビス(p-トルイジン
、スベリン酸ジアニリド、アゼライン酸ジアニリド、セ
ドデカン二酸ジアニリド、1,14-テトラデカン二酸
カルバリル酸トリアニリド、プロペントリカルボン酸
酸トリアニリド、エタントラカルボン酸テトラアニリ
トラカルボン酸ペンタアニリド、テトラデカンヘキサ
ンジアミン四酢酸テトラアニリド、1,4-シクロヘキサ
ーシクロヘキサンカルボン酸-4-シクロヘキサンカル
ルボン酸-p-トリステアリン酸アミド、1,4-シクロヘキ
1,4-シクロヘキサンジカルボン酸ジベンジルアミド、
ビス(4-シクロヘキサンカルボン酸ジベンジルアミド)、
アミド、1,4-シクロヘキサンジカルボン酸ビス(p-トル
アニリド、安息香酸-p-トリステアリン酸アミド、安息
、2,6-ナフタレンジカルボン酸ジベンジルアミド、ト
メシン酸トリ(4-シクロヘキサンカルボン酸トリ-p-トル
ド、トリメシン酸トリベンジルアミド、トリメリト酸

10

20

30

40

50

アセチル-*o*-フェニレンジアミン、*N*、*N'*-ジアセチル-*p*-フェニレンジアミン、*N*、*N'*-ジアセチル-2, 3-ジアミノトルエン、*N*、*N'*-ジアセチル-1, 5-ジアミノナフタレン、*N*、*N'*、*N''*-トリアセチル-1, 3, 5-トリアミノベンゼン、*N*、*N'*-ジシクロヘキサンカルボニル-*o*-フェニレンジアミン、*N*、*N'*-ジシクロヘキサンカルボニル-*p*-フェニレンジアミン、*N*、*N'*-ジシクロヘキサンカルボニル-1, 5-ジアミノナフタレン、*N*、*N'*、*N''*-トリシクロヘキサンカルボニル-1, 3, 5-トリアミノベンゼン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-1, 4-ジアミノブタン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-1, 6-ジアミノヘキサン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-1, 4-ジアミノシクロヘキサン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-*o*-フェニレンジアミン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-*p*-フェニレンジアミン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-2, 3-ジアミノトルエン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-1, 5-ジアミノナフタレン、*N*、*N'*、*N''*-トリベンゾイル-1, 3, 5-トリアミノベンゼン、キシリレンビスステアリン酸、トリイレンビスステアリン酸、ジフェニルメタンビスステアリン酸、ジフェニルメタンビスラウリル酸、*N*-フェニル-*N'*-ステアリン酸が挙げられ、透明性と耐熱性が向上するという観点から、エチレンビス安息香酸アミド、*m*-キシリレンビスステアリン酸アミド、*p*-キシリレンビスステアリン酸アミド、2, 6-ナフタレンジカルボン酸ジシクロヘキシルアミド、トリメシン酸トリス(1-ブチルアミド)、トリメシン酸トリス(2-メチルシクロヘキシルアミド)、アジピン酸ジアニリド、アジピン酸ジベンジルアミド、アジピン酸ビス(4-シクロヘキシルアニリド)、アジピン酸ビス(*p*-トルイジンアミド)、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸ジアニリド、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸ビス(*p*-トルイジンアミド)、テレフタル酸ジアニリド、テレフタル酸ジベンジルアミド、2, 6-ナフタレンジカルボン酸ジアニリド、トリメシン酸トリアニリド、トリメシン酸トリ(4-シクロヘキシルアニリド)、トリメシン酸トリ-*p*-トルイジンアミド、トリメシン酸トリベンジルアミド、トリメリト酸トリベンジルアミド、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸ビス(*p*-トルイジンアミド)、*N*、*N'*-ジシクロヘキサンカルボニル-1, 5-ジアミノナフタレン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-1, 4-ジアミノブタン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-1, 4-ジアミノシクロヘキサン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-*p*-フェニレンジアミン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-1, 5-ジアミノナフタレンが好ましく、さらにトリメシン酸トリス(1-ブチルアミド)、2, 6-ナフタレンジカルボン酸ジシクロヘキシルアミド、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸ジアニリド、テレフタル酸ジアニリド、テレフタル酸ジベンジルアミド、*N*、*N'*-ジシクロヘキサンカルボニル-1, 5-ジアミノナフタレン、*N*、*N'*-ジベンゾイル-1, 4-ジアミノシクロヘキサンがより好ましく、さらにトリメシン酸トリス(1-ブチルアミド)、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸ジアニリド、テレフタル酸ジアニリドが最も好ましい。

【0037】

本発明で用いるアミド化合物の配合量は、特に限定されるものではないが、透明性と耐熱性が向上するという観点から、ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂の合計を100重量部としたときに、0.1~10重量部が好ましく、さらに0.1~8重量部がより好ましく、特に0.1~5重量部が最も好ましい。0.1重量部よりも少ない範囲では、透明性を損なう場合がある。

【0038】

本発明で用いるアミド化合物の製造方法としては、特に限定されるものではなく、脂肪族、脂環族もしくは芳香族カルボン酸およびその誘導体と脂肪族、脂環族もしくは芳香族アミンおよびその誘導体を用いて、公知の方法によりアミド化することにより製造することができる。

【0039】

本発明の成形体において、透明とは、新聞など文字が印刷されている印刷物に成形体を重ねたときに、その文字を読みとることができる部分があることをいう。本発明においては

成形体の厚みが20 μ m以上である部分でヘイズ値が30%以下である部分を有する成形体であることが好ましく、ヘイズ値が20%以下である部分を有する成形体であることがより好ましく、15%以下である部分を有する成形体であることがさらに好ましい。なかでも、成形体の厚みが100 μ m以上である部分で上記ヘイズ値を満たす部分を有する成形体であることがより好ましく、成形体の厚みが500 μ m以上、特に好ましくは1mm以上である部分で、上記ヘイズ値を満たす部分を有するものである。なお、ヘイズは、JIS-K7105に準じて、ヘイズメーターなどを用いて測定することができる。

【0040】

本発明の成形体は、下記式(1)により表される成形体の結晶化の割合が60%以上と、十分に結晶化した成形体である。

$$[(\Delta H_m - \Delta H_c) / \Delta H_m] \times 100 \quad (1)$$

〔式中、 ΔH_m は成形体の結晶融解エンタルピーを表し、 ΔH_c は成形体の昇温時結晶化エンタルピーを表す。〕

なお、 ΔH_m および ΔH_c は、示差走査熱量計(DSC)による熱的測定により求めることができ、成形体から切り出した試料10mg、窒素雰囲気下中、昇温速度20℃/分で0℃～30℃の温度領域から200℃以上の温度領域まで昇温することにより測定される。

【0041】

本発明において、上記式(1)で表される成形体の結晶化の割合は、高い方が好ましいが、具体的には70%以上であることが好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。上記式(1)で表される成形体の結晶化の割合が60%以上、好ましくは80%以上であれば、耐熱性が著しく向上する。

【0042】

ΔH_m および ΔH_c については、上記(1)式で表される割合が本発明の範囲を満足する限り特に限定されるものではないが、 ΔH_m が高く、 ΔH_c が低い方が結晶化の割合が大きくなり、耐熱性に優れるという効果を奏するため好ましい。具体的には ΔH_m が20J/g以上、好ましくは40J/g以上、より好ましくは50J/g以上、さらに好ましくは60J/g以上である場合に耐熱性が著しく向上し、 ΔH_c が30J/g以下、好ましくは20J/g以下、より好ましくは10J/g以下、さらに好ましくは1J/g未満である場合に耐熱性が著しく向上する。

【0043】

また、本発明においては、成形体中のポリ乳酸樹脂の結晶化の程度が高いことが好ましい。成形品中のポリ乳酸樹脂の結晶化の程度としては、下記式(2)で表される式の値、すなわちエンタルピーの合計量が、20J/g以上、好ましくは30J/g以上、より好ましくは40J/g以上である場合に、成形体においてポリ乳酸樹脂が結晶化していると判断でき、この値が20J/g以上、好ましくは30J/g以上、より好ましくは40J/g以上であれば成形体の耐熱性が著しく向上する。

$$\Delta H_{c1d} + \Delta H_{c2u} \quad (2)$$

〔式中、 ΔH_{c1d} は1回目の測定のポリ乳酸樹脂の降温時結晶化エンタルピーを表し、 ΔH_{c2u} は2回目の測定のポリ乳酸樹脂の昇温時結晶化エンタルピーを表す。〕

ここで、 ΔH_{c1d} および ΔH_{c2u} は、DSCによる熱的測定から求めることができ、成形体から切り出した試料10mg、窒素雰囲気下中、1回目の測定として、昇温速度20℃/分で30℃から200℃まで昇温し、200℃で5分間保持した後、降温速度20℃/分で200℃から30℃まで降温し、30℃で1分間保持した後、さらに2回目の測定として、昇温速度20℃/分で30℃から200℃まで昇温し、200℃で5分間保持した後、降温速度20℃/分で200℃から30℃まで降温することにより測定される。この測定において、1回目の測定の降温時に観察されるポリ乳酸樹脂の結晶化エンタルピーが ΔH_{c1d} に相当し、2回目の測定の昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂の結晶化エンタルピーが ΔH_{c2u} に相当する。

【0044】

本発明の成形体の製造方法としては、特に限定されるものではなく、射出成形、押出成形、ブロー成形、インフレーション成形、真空圧空成形など一般に行われる成形方法をいずれも適用することができる。

【0045】

本発明において、透明かつ上記(1)式で表される結晶化の割合が本発明で規定した範囲内である成形品を得るためには、例えば上記ポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂、必要に応じて任意成分であるアミド化合物を配合してなる樹脂組成物を成形し、その後ポリ乳酸樹脂のガラス転移温度(T_g)以上ポリ乳酸樹脂の融点(T_m)以下温度範囲で熱処理する方法が好ましく挙げられる。ここで、 T_g および T_m は、配合に供するポリ乳酸樹脂の値を意味する。本発明の成形体に用いる樹脂組成物はポリ乳酸樹脂にポリアセタール樹脂を含有するため、成形体を加熱処理しても、優れた透明性を保持しながら、十分に結晶化させることが可能である。

10

【0046】

熱処理する方法は、ポリ乳酸樹脂のガラス転移温度(T_g)以上融点(T_m)以下温度範囲で、一定温度で熱処理する方法、連続的に、もしくは、少なくとも2段階以上の温度で段階的に昇温して熱処理する方法などの方法を好ましく採用することができる。その中でも、透明性と耐熱性の観点から、連続的、もしくは、少なくとも2段階以上の温度で段階的に昇温して熱処理する方法がより好ましく、具体的には、前記温度範囲において、昇温速度が、 $0.5^{\circ}\text{C}/\text{分}$ 、好ましくは $0.3^{\circ}\text{C}/\text{分}$ 、より好ましくは $0.25^{\circ}\text{C}/\text{分}$ となるように連続的に昇温する方法、もしくは、1分、好ましくは10分、より好ましくは15分、さらに好ましくは30分ごとに 60°C 、好ましくは 40°C 、より好ましくは 20°C 、さらに好ましくは 10°C ずつ段階的に昇温する方法、などいずれをも適用することができるが、透明性と耐熱性に優れた成形体得られるという観点から、少なくとも2段階以上、より好ましくは3段階以上の温度に設定して段階的に昇温する方法が好ましい。

20

【0047】

熱処理の温度範囲については、好ましくは $T_g + 5^{\circ}\text{C} \sim T_m - 10^{\circ}\text{C}$ 、より好ましくは $T_g + 7^{\circ}\text{C} \sim T_m - 20^{\circ}\text{C}$ の温度範囲である。さらにポリ乳酸樹脂とポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物の結晶化温度(T_c)が、 $T_m - 20^{\circ}\text{C}$ より低い温度である場合には、 $T_g + 7^{\circ}\text{C} \sim T_c$ の温度範囲、好ましくは $T_g + 7^{\circ}\text{C} \sim T_c - 5^{\circ}\text{C}$ 、より好ましくは $T_g + 7^{\circ}\text{C} \sim T_c - 15^{\circ}\text{C}$ 、さらに好ましくは $T_g + 7^{\circ}\text{C} \sim T_c - 30^{\circ}\text{C}$ の温度範囲で熱処理した後、 T_c 以上、好ましくは $T_c + 5^{\circ}\text{C}$ 以上、より好ましくは $T_c + 10^{\circ}\text{C}$ 以上で熱処理するというように段階的に昇温することが特に好ましい。熱処理の温度が T_g より低い場合は、ほとんど結晶化せず、 T_m より高い場合は、結晶化時間を短くしても透明かつ結晶化した成形体得られにくい。

30

【0048】

熱処理の時間については、成形体が十分に結晶化する時間であれば、特に限定されるものではないが、少なくとも10秒以上、より好ましくは1分以上、より好ましくは10分以上、特に好ましくは30分以上であり、1時間程度熱処理すれば十分に結晶化する。

【0049】

本発明の成形体を形成する樹脂組成物に対しては、本発明の目的を損なわない範囲で、充填剤(ガラス繊維、炭素繊維、金属繊維、天然繊維、有機繊維、ガラスフレーク、ガラスビーズ、セラミックスファイバー、セラミックビーズ、アスベスト、ワステナイト、タルク、クレイ、マイカ、セリサイト、ゼオライト、ペントナイト、モンモリロナイト、合成マイカ、ドロマイト、カオリン、微粉ケイ酸、長石粉、チタン酸カリウム、シラスバルーン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化チタン、ケイ酸アルミニウム、酸化ケイ素、石膏、ノバキュライト、ドーソナイトおよび白土など)、安定剤(ヒンダードフェノール系、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、ベンゾエート系およびシアノアクリレート系などの紫外線吸収剤および酸化防止剤)、滑剤または可塑剤(高級脂肪酸や酸エステル系および酸アミド系、さらに高級アルコールなど)、離型剤(モンタン酸およびその塩、そのエステル、そのハーフエ

40

50

ステル、ステアリルアルコール、ステラアマイドおよびエチレンワックスなど）、変色防止剤（亜リン酸塩、次亜リン酸塩など）、難燃剤（ハロゲン系難燃剤、燐系やシリコーン系の非ハロゲン系難燃剤など）、染料および顔料を含む着色剤、結晶核剤（タルク、有機カルボン酸金属塩など）および帯電防止剤などの添加剤を含有させてもよい。これらの添加剤は単独ないし2種以上を併用して用いることができる。

【0050】

また、本発明の成形体を形成する樹脂組成物に対して、本発明の目的を損なわない範囲で、他の熱可塑性樹脂（例えばポリエチレン、ポリプロピレン、アクリル樹脂、ポリアミド、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミドおよびポリエーテルイミドなど）および熱硬化性樹脂（例えばフェノール樹脂、メラミン樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂およびエポキシ樹脂など）および軟質熱可塑性樹脂（例えばエチレン／グリシジルメタクリレート共重合体、ポリエステルエラストマー、ポリアミドエラストマー、エチレン／プロピレンターポリマーおよびエチレン／ブテンー1共重合体など）などの少なくとも1種以上をさらに含有させることができる。

【0051】

本発明において、樹脂組成物の製造方法は特に限定されるものではないが、例えばポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂、必要に応じて任意成分であるアミド化合物、もしくはその他の添加剤を予めブレンドした後、融点以上において、1軸または2軸押出機で、均一に熔融混練する方法や溶液中で混合した後溶媒を除く方法などが好ましく用いられる。

【0052】

本発明の成形体としては、射出成形品、押出成形品、ブロー成形品、フィルムおよびシートなどが挙げられる。本発明の効果を十分に活かす観点から、厚みが20 μ m以上の部分を有する成形体であることが好ましく、100 μ m以上の部分を有する成形体であることが特に好ましく、1mm以上の部分を有する成形体であることが好ましい。さらに、その透明性を十分活かす観点から、厚みが20 μ m～3mmの部分を有する成形体であることが好ましく、20 μ m～2mmの部分を有する成形体であることがより好ましく、20 μ m～1.5mmの部分を有する成形体であることがさらに好ましい。

【0053】

なお、本発明の成形体は、延伸処理をしなくても十分に透明性と耐熱性に優れた成形体として得ることができ、厚みが100 μ m以上、好ましくは500 μ m以上、さらに好ましくは1mm以上の未延伸フィルムおよびシートとして利用することができる。成形体の厚みの上限は特に限定されるものではないが、3mm以下が好ましく、2mm以下がより好ましく、1.5mm以下がさらに好ましい。

【0054】

また、これら本発明の成形品、フィルム、シートおよび繊維は、電気・電子部品、建築部材、自動車部品、各種包装材料および日用品など各種用途に利用することができる。

【0055】

【実施例】

以下、実施例により本発明の構成、効果をさらに詳細に説明する。ここで、実施例中の部数は、重量部を示す。

【0056】

なお、実施例中の各種特性の評価は、次に説明する方法にしたがって行った。

【0057】

〔透明性〕

日本電色工業製ヘイズメーターNDH-300Aを用いて、JIS-K7105に準じ、成形体から縦横3cm角に切り出した試料のヘイズを測定した。

【0058】

〔結晶化の割合〕

パーキンエルマー製 D S C 7 を用いて、成形品から切り出した試料 10 mg を窒素雰囲気下中、昇温速度 20 °C / 分で 30 °C から 200 °C まで昇温し、得られた昇温時結晶化エンタルピー (ΔH_c) および結晶融解エンタルピー (ΔH_m) を用いて下記式 (1) から結晶化の割合を求めた。

$$[(\Delta H_m - \Delta H_c) / \Delta H_m] \times 100 \quad (1)$$

[式中、ΔH_m は成形体の結晶融解エンタルピーを表し、ΔH_c は成形体の昇温時結晶化エンタルピーを表す。]

さらに、実施例 14 ~ 21 および比較例 4 ~ 6 については、上記測定に加えて、パーキンエルマー製 D S C 7 を用いて、成形品から切り出した試料 10 mg、窒素雰囲気下中、1 回目の測定として、昇温速度 20 °C / 分で 30 °C から 200 °C まで昇温し、200 °C で 5 分間保持した後、降温速度 20 °C / 分で 200 °C から 30 °C まで降温し、30 °C で 1 分間保持した後、さらに 2 回目の測定として、昇温速度 20 °C / 分で 30 °C から 200 °C まで昇温し、200 °C で 5 分間保持した後、降温速度 20 °C / 分で 200 °C から 30 °C まで降温し、得られた 1 回目の測定の降温時に観察されるポリ乳酸樹脂の結晶化エンタルピー (ΔH_{c1d}) および 2 回目の測定の昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂の結晶化エンタルピー (ΔH_{c2u}) を用いて下記式 (2) からポリ乳酸樹脂の結晶化の状態を評価した。下記式 (2) で求められる値が多い方が、成形体中のポリ乳酸樹脂がより結晶化していると判断される。

$$\Delta H_{c1d} + \Delta H_{c2u} \quad (2)$$

[式中、ΔH_{c1d} は 1 回目の測定のポリ乳酸樹脂の降温時結晶化エンタルピーを表し、ΔH_{c2u} は 2 回目の測定のポリ乳酸樹脂の昇温時結晶化エンタルピーを表す。]

[耐熱性]

得られた成形体もしくは切り出した試料を熱風乾燥機中で片端を水平支持し、徐々に昇温し成形体先端が垂れ下がった温度を測定し熱変形温度とした。

【0059】

[実施例 1 ~ 9、比較例 1 ~ 2]

D 体の含有量が 2 % であり、P M M A 換算の重量平均分子量が 17 万、ガラス転移温度が 60 °C、融点が 170 °C であるポリ L 乳酸樹脂、190 °C で測定したメルトインデックス値が 27 g / 10 分であり、融点が 170 °C であるポリアセタールコポリマー (東レ製アミラス S 731) を、それぞれ表 1 に示した割合で混合し、40 mm 径の 1 軸押出機で、シリンダー温度 200 °C、回転数 50 r p m の条件で溶融混練を行うことにより樹脂組成物を得た。

【0060】

得られた樹脂組成物を、射出成形機を用い、シリンダー温度 200 °C、金型温度 20 °C で成形し、厚み 1 mm × 縦 10 cm × 横 10 cm のシート状成形品を作製し、結晶化温度、結晶化の割合、ヘイズ、熱変形温度を測定した。さらに、このシートを熱風乾燥機を用いて、下記の条件で熱処理した後、結晶化の割合、ヘイズ、熱変形温度を測定した。結果を表 1 に併せて示す。

熱処理方法 a : 70 °C で 20 分 → 90 °C で 20 分 → 110 °C で 10 分

熱処理方法 b : 80 °C で 35 分 → 140 °C で 15 分

熱処理方法 c : 110 °C で 50 分

【0061】

【表 1】

表1

		実施例										比較例	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	
ポリ乳酸	重量部	90	90	90	80	80	80	70	70	70	100	100	
	重量部	10	10	10	20	20	20	30	30	30	—	—	
ポリアセタール	Tc	100	100	100	105	105	105	106	106	106	130	130	
	ΔHc	31	31	31	30	30	30	29	29	29	15	15	
	ΔHm	49	49	49	56	56	56	71	71	71	15	15	
	結晶化の割合	37	37	37	46	46	46	59	59	59	0	0	
	ヘイズ	7	7	7	7	7	7	9	9	9	6	6	
熱処理前	熱変形温度	60	60	60	63	63	63	67	69	69	55	55	
		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	
熱処理方法	ΔHc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ΔHm	51	50	49	60	59	59	75	72	71	39	38	
	結晶化の割合	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	ヘイズ	13	14	19	11	13	20	14	16	18	92	94	
	熱変形温度	98	98	98	100	100	100	102	102	102	65	65	

熱処理方法 a: 70℃で20分→90℃で20分→110℃で10分
b: 80℃で35分→140℃で15分
c: 110℃で50分

【0062】
表1の結果から明らかなように、本発明のポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物からなる成形体は、透明性と耐熱性に優れた透明かつ結晶化した成形体であることがわかる。

【0063】

【実施例10～13、比較例3】

D体の含有量が2%であり、PMMMA換算の重量平均分子量が17万、ガラス転移温度が60℃、融点が170℃であるポリL乳酸樹脂、190℃で測定したメルトインデックス値が27g/10分であり、融点が170℃であるポリアセタールコポリマー（東レ製アミラス731）を、それぞれ表1に示した割合で混合し、40mm径の1軸押出機で、温度200℃、回転数50rpmの条件で溶融混練を行うことにより樹脂組成物を得た。

【0064】

得られた樹脂組成物を、一軸押出機で、シリンダー温度200℃、Tダイ口金温度200℃で押し出し、0℃に設定した冷却ロールで冷却し、厚み250μmのシート状成形体を作製した後、10cm角の大きさの試料として切り出し、結晶化温度、結晶化の割合、ヘイズ、熱変形温度を測定した。さらに、この試料を熱風乾燥機を用いて、80℃で30分→140℃で10分の条件で熱処理した後、結晶化の割合、ヘイズ、熱変形温度を測定した。結果を表2に併せて示す。

【0065】

【表2】

表2

		実施例				比較例	
		10	11	12	13	3	100
		90	80	70	60	40	—
ポリ乳酸	重量部	10	20	30	40	100	130
	重量部	100	105	106	107	107	107
ポリアセタール	T _c	46	40	37	31	15	15
	ΔH _c	49	56	71	75	59	0
熱処理前	結晶化の割合	6	29	48	59	55	55
	ヘイズ	5	5	7	15	4	4
熱処理後	熱変形温度	55	56	56	57	55	55
	ΔH _c	0	0	0	0	0	0
熱処理後	ΔH _m	51	59	72	79	39	39
	結晶化の割合	100	100	100	100	100	100
熱処理後	ヘイズ	9	9	12	22	92	92
	熱変形温度	95	98	100	105	61	61

【0066】

表2の結果から明らかなように、本発明のポリ乳酸樹脂およびポリアセタール樹脂を配合してなる樹脂組成物からなる成形体は、透明性と耐熱性に優れた透明かつ結晶化した成形体であることがわかる。

【0067】

〔実施例14～21、比較例4～6〕

D体の含有量が2%であり、PMMMA換算の重量平均分子量が17万、ガラス転移温度が60℃、融点が170℃であるポリL乳酸樹脂、190℃で測定したメルトインデックス値が27g/10分であり、融点が170℃であるポリアセタールコポリマー（東レ製アミラスS731）および表2に示すアミド化合物を、それぞれ表2に示した割合で混合し、40mm径の1軸押出機で、温度200℃、回転数50rpmの条件で溶融混練を行うことにより樹脂組成物を得た。

【0068】

ここで使用したアミド化合物は下記の通りである。なお、A～Dは、対応するカルボン酸クロリドとアミン化合物を公知の方法に従い反応させて得た。

10

A：テレフタル酸ジアニリド

B：トリメシン酸トリス（t-ブチルアミド）

C：1,4-シクロヘキサジカルボン酸ジアニリド

D：N,N'-ジシクロヘキサカルボニル-1,4-ジアミノシクロヘキサン

E：エチレンビスラウリン酸アミド（日本化成製スリパックスL）

得られた樹脂組成物を、射出成形機を用い、シリンダー温度200℃、金型温度20℃で成形し、厚み1mm×縦10cm×横10cmの成形体を作製し、結晶化の割合、ヘイズ、熱変形温度を測定した。さらに、この成形体を熱風乾燥機を用いて、下記の条件で熱処理した後、結晶化の割合、ヘイズ、熱変形温度を測定した。結果を表3に併せて示す。

20

熱処理方法a：70℃で15分→90℃で15分→110℃で10分

熱処理方法b：110℃で40分

【0069】

【表3】

表3

		実施例														比較例					
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
ポリ乳酸	重量部	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	重量部	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ポリアセタール	種類	A	A	A	B	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	重量部	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
アミド化合物	ΔHc	31	31	30	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	ΔHm	58	58	63	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
熱処理前	結晶化の割合	47	47	52	46	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	ヘイズ	7	7	8	7	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
熱処理方法	熱変形温度	65	65	66	64	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
		a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
熱処理後	ΔHc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΔHm	61	59	65	60	59	58	60	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
熱処理後	結晶化の割合	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ヘイズ	10	18	11	11	10	9	14	19	14	19	14	19	14	19	14	19	14	19	14	19
熱処理方法	熱変形温度	102	102	103	102	101	100	101	100	101	100	101	100	101	100	101	100	101	100	101	100
	ΔHc1d+ΔHc2u	31	31	33	30	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29

アミド化合物 A:テレフタル酸ジアニリド
B:トリメジン酸トリス(4-ブチルアミド)
C:1, 4-ジクロロヘキサンジカルボン酸ジアニリド
D:N,N'-ジクロロヘキサンカルボニル-1, 4-ジアジミジクロロヘキサン
E:エチレンビスラウリン酸アミド
熱処理方法 a:70℃で15分→90℃で15分→110℃で10分
b:110℃で40分

【0070】
表3の結果から明らかなように、ポリ乳酸樹脂、ポリアセタール樹脂およびアミド化合物を配合してなる樹脂組成物からなる成形体は、透明性と耐熱性に優れ、かつ十分に結晶化した成形体であることがわかる。

【 0 0 7 1 】

【 発 明 の 効 果 】

以上説明したように、本発明の成形体は、透明性と耐熱性に優れた優れた結晶化した成形体であり、これらの優れた特性を生かして、電気・電子部品、建築部材、自動車部品、各種包装材料および日用品など各種用途に利用することができる。

フロントページの続き

F ターム(参考) 4F071 AA40 AA43 AA81 AA84 AA86 AA88 AC12 AF11 AF30 AF45
AG28 AH03 AH04 AH07 AH12 BA01 BB05
4J002 CB002 CF181 EP016 EP026 EP036 FD010 FD020 FD030 FD160 FD200
FD206 GG02 GK00 GN00 GQ00